

TM 150EB2 可焊接導電膠 产品数据表

提高可靠性

改善導熱性

消除氣體逸出

简介

TM 150EB2 可焊導電膠是一種自填充、自流平、自焊接的黏合劑，可用作LED、CSP、QFP等裝置的晶片黏著劑和導熱介面材料，特別適用於裸晶片和散熱器之間的連接，可取代導電膠（銀膠）或焊料（如焊膏或預成型焊料）。與導電膠（銀膠）相比，TM 150EB2 可焊導電膠具有更高的電導率和熱導率穩定性，能夠輕鬆填充間隙並實現晶片自流平，且易於控制黏接厚度。與傳統焊料相比，TM 150EB2 可焊導電膠消除了焊接過程中的氣體逸出、晶片傾斜和位移以及焊料溢出等問題。TM 150EB2 可焊導電膠固化後，焊接界面將被封裝，從而使焊接金屬界面受到3D聚合物網路的保護，能夠耐受惡劣的環境條件。

物理特性

产品名称	TM 158D 高導熱黏合劑
合金	銀
樹脂類型	環氧樹脂
未固化材料性能	
项目	数值
比重(ASTM D 1475-60)	3.5 – 4.5 g/cc
粘度	20 – 50 kcp
已固化材料性能	
Tg (ASTM D3418-82)	39 °C
C.T.E (ASTM E831) PPM/°C	23.5
抗拉強度 (MPa)	20

楊氏模量(MPa)	50-100
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm

推薦固化工藝

採用工業標準低溫無鉛回流焊接製程 (峰值溫度 140 – 170°C)

儲存和保存期限

如果將材料保存在密封的原包裝容器中，並在 -40°C 的溫度下儲存，保存期限為 6 個月。超過此期限儲存可能會導致黏度升高。請防潮、防蒸發並防止混入異物。蒸發和污染會嚴重影響這些產品的加工性能。

安全須知

TM 150EB2 是一種安全無毒的材料。但是，建議在處理該材料時遵守一般的衛生操作規範。更多詳細信息，請參閱我們的安全資料表 (SDS)。

包裝規格

TM150EB2 膠合劑提供 10cc 和 30cc 兩種包裝。根據客戶需求，也可提供其他包裝規格。如需訂購信息，請聯繫 YINCAE 公司。